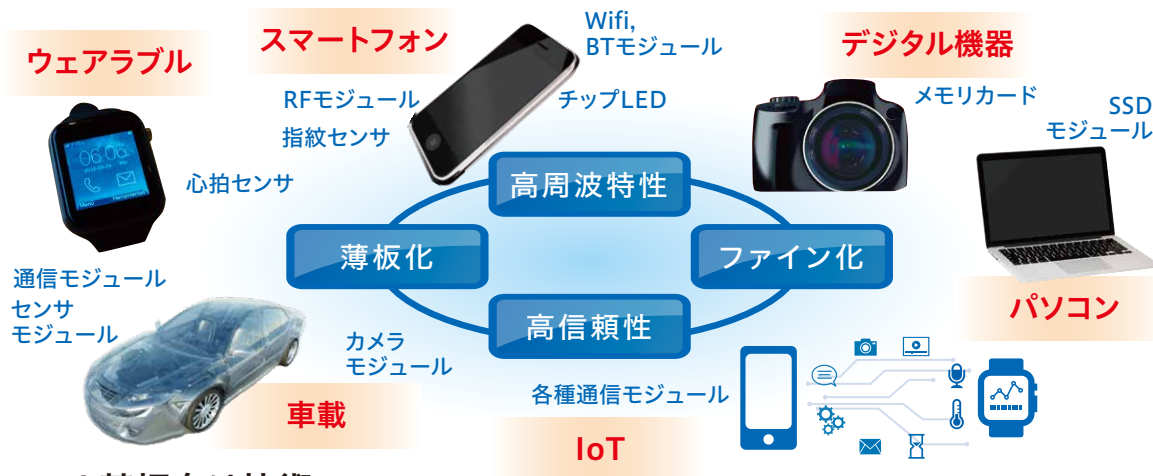


モジュール基板

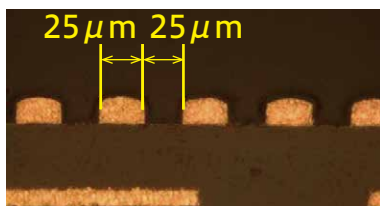
Module Substrate

各種機器への開発、ご採用実績例 Cases of technology development and production example

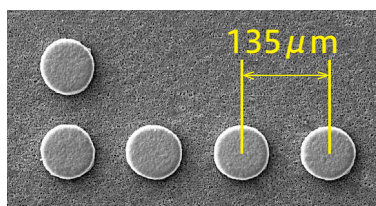


モジュール基板向け技術

1. ファインパターン及び小径Viaを適用した高密度化が可能



MSAP工法 L/S=25/25μm パターン



レーザービアピッチ:135μm
Laser Via pitch : 135μm

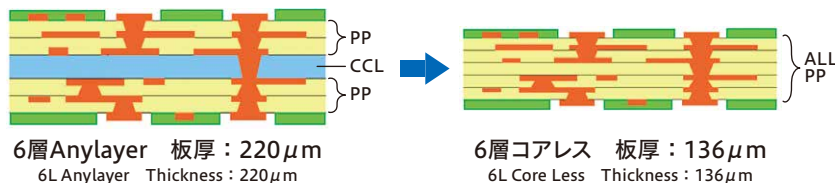
2. 各種構造へ対応可能(貫通構造、ビルドアップ構造、Anylayer構造) 薄厚化ご要求に対しては、コアレス工法及びDFSR(フィルムタイプ ソルダーレジスト)適用可能



6層コアレス基板 断面写真
6L Core Less Substrate Cross section

●6層Anylayer vs 6層コアレス 板厚比較

Board thickness comparison between 6L Anylayer and 6L Core Less

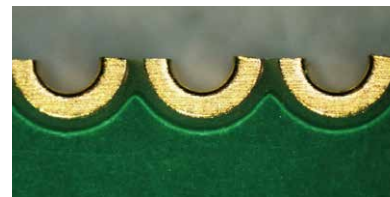


3. 様々なご要求仕様・特性に応えるべく、汎用材(HF)、高Tg・低CTE材、低Dk・Df材まで幅広い材料に対応可能

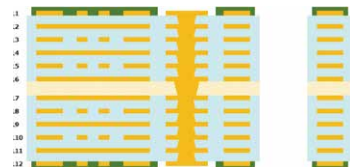
4. 各種実装方法及び使用用途に合わせた各種表面処理への対応可能
OSP、無電解Ni/Au、無電解Ni/Pd/Au、電解Ni/Au 他

5. 特殊仕様: 端面スルーホール、キャビティ構造等にも対応可能 ※応相談

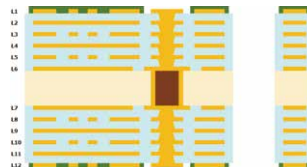
6. 高い信頼性を要求される車載機器向けモジュール基板への対応可能
通信モジュール、カメラモジュール 等



端面スルーホール Edge-Plating
Drill : 0.5mm, Pitch : 0.9mm



通信モジュール(12層Any layer) 基板構造図



通信モジュール(12層HDI 5-2-5) 基板構造図